

| | |
|-------------------|---------------------------|
| ESENDER_LOGIN: | ENOTICES |
| CUSTOMER_LOGIN: | ECAS_ncvazzfr |
| NO_DOC_EXT: | 2020-068577 |
| SOFTWARE_VERSION: | 9.13.1 |
| ORGANISATION: | ENOTICES |
| COUNTRY: | EU |
| PHONE: | / |
| E_MAIL: | ufficioacquisti@polimi.it |

| | |
|----------------------------|------------|
| LANGUAGE: | IT |
| CATEGORY: | ORIG |
| FORM: | F01 |
| VERSION: | R2.0.9.S03 |
| DATE_EXPECTED_PUBLICATION: | / |

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano

Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32

Città: Milano

Codice NUTS: ITC4C

Codice postale: 20133

Paese: Italia

Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture - Dipartimento DEIB

E-mail: ufficioacquisti-deib@polimi.it

Tel.: +39 0223999300

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.polimi.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.polimi.it/impresa/partecipaaunagara>

I.2) **Appalto congiunto**

I.3) **Comunicazione**

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Organismo di diritto pubblico

I.5) **Principali settori di attività**

Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Fornitura di una macchina per il bonding semiautomatica per il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano

II.1.2) **Codice CPV principale**

42900000

II.1.3) **Tipo di appalto**

Forniture

II.1.4) **Breve descrizione:**

Avviso di manifestazione di interesse per confermare i presupposti al ricorso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.63, comma2, lett.b) punto 2 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di una macchina per il bonding semiautomatica per il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 99 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:****II.2.2) Codici CPV supplementari****II.2.3) Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Il Politecnico di Milano intende acquistare una nuova macchina per il bonding semiautomatica a supporto di gran parte delle attività di ricerca della Sezione Elettronica del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria inerenti lo sviluppo, la qualificazione, l'applicazione di circuiti integrati custom, sviluppati direttamente dai colleghi della sezione oppure dai gruppi partner e che dovranno essere opportunamente assemblati effettuando le interconnessioni elettriche con i package, le schede o con altri chip (bonding) . A tal fine si rende necessaria una macchina cosiddetta semi-automatica o automatica con posizionamento manuale dei campioni su cui effettuare il bonding, in cui la testa che esegue il bonding può ruotare di quasi 360°, andando, quindi, a raggiungere con la corretta orientazione anche punti apparentemente inaccessibili in una macchina manuale. Il sistema di vista è realizzato con una telecamera collineare alla testa di bonding e l'eventuale microscopio che accompagna la macchina è solo per un uso di controllo e ispezione, ma non di puntamento. La regolazione delle quote verticali per l'esecuzione del bonding è effettuata in automatico mediante un opportuno sensore che avverte, con minima forza esercitata, il contatto tra la punta e la superficie su cui effettuare la microsaldatura. Il piano secondo il quale eseguire le interconnessioni è definito a priori e caricato nella macchina, può essere verificato dall'operatore prima di eseguire le interconnessioni e, successivamente, viene seguito in maniera automatica dalla macchina. In tal modo la ripetibilità della forma delle interconnessioni e la precisione di localizzazione dei singoli bonding è svincolata dall'operatore. Le caratteristiche tecniche che la nuova macchina da acquistare deve soddisfare sono molteplici, tra queste si evidenzia maggiormente di privilegiare la massima versatilità della macchina per il bonding, senza pregiudicarne le prestazioni, in modo da avere la possibilità di effettuare un adeguamento della macchina alle diverse esigenze (ad esempio, ma non esaustivo, diverse tecnologie di bonding (wedge, ball, heavy wire, ribbon), eventuale verifica della qualità della microsaldatura realizzata mediante tecniche di wire pull test e ball shear test).

II.2.14) Informazioni complementari**II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:**

01/07/2020

Sezione IV: Procedura**IV.1) Descrizione****IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni**VI.3) Informazioni complementari:**

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d'interesse.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La documentazione deve essere fornita esclusivamente in formato elettronico e potrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo pecdeib@cert.polimi.it .

I soggetti in grado di soddisfare i requisiti minimi inderogabili richiesti indicati testo dell'avviso possono presentare la propria candidatura presentando:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
2. scheda tecnica della macchina per il bonding offerta

Il messaggio deve avere per oggetto: "Candidatura per la fornitura di una macchina per il bonding semiautomatica".

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON saranno considerati.

Gli operatori economici interessati devono presentare candidatura allegando obbligatoriamente documentazione illustrativa e il DGUE.

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15/06/2020.

Eventuali documentazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Gli operatori economici interessati sono invitati ad iscriversi alla piattaforma Sintel e a qualificarsi per il Politecnico di Milano. Informazioni relative alle modalità di iscrizione e qualifica sono reperibili sul sito <http://www.polimi.it/imprese/proponiti-come-fornitore/>, <http://www.arca.regione.lombardia.it> e tramite il call center di ARCA.

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
27/05/2020